



工業技術研究院 光電構裝、封裝材料暨有機太陽能電池相關技術專 利讓與案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可累積強有力的智慧財產權能量，並可藉此提升競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

三、讓與標的：

本讓與案包含光電構裝、封裝材料暨有機太陽能電池等相關專利共 22 案 53 件（以下簡稱「讓與標的」）。「讓與標的」共分為三個類別：（一）光電構裝/封裝材料(11 案 30 件)、(二)有機太陽能電池(9 案 21 件)及(三)其他(2 案 2 件)。

「讓與標的」相關資訊詳如附件或請參考台灣技術交易資訊網 (<https://www.twtm.com.tw/Web/index.aspx>)、及工研院研發成果公告網站

(<https://www.itri.org.tw/chi/Content/Bulletin/list.aspx?&SiteID=1&MmmID=3000&SY=0&CatID=1>)。

四、公開說明會與領標：

1. 公開說明會將於民國（下同）108 年 9 月 25 日 14 時整於工研院中興院區 51 館 110-1 室舉辦。
2. 公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 108 年 9 月 24 日中午 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「光電構裝、封裝材料暨有機太陽能電池相關技術專利讓與案公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十二、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 108 年 9 月 24 日下午 5 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。
3. 自本標案公告日起至截標日 108 年 10 月 1 日下午 5 時整(含)止，得洽



「技轉法律中心」聯絡人領取標單。

五、投標方法：

1. 本標案採通訊或親送方式投標。投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同押標金、公司設立證明文件（如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本）、廠商基本資料表(以下統稱「投標文件」)，裝入信封密封之，並在信封上註明「光電構裝、封裝材料暨有機太陽能電池相關技術專利讓與案投標」，於截標日 108年10月1日下午5時整（含）前（以送達收據為憑）掛號寄達或親送至：
31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室
工研院技轉法律中心 方先生 收
2. 本標案採「案」方式投標。「讓與標的」以同一發明為一案。本標案採一案一標，即同一案專利不分開投標/開標。
3. 本標案不得共同投標或重複投標。
4. 投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。
5. 投標廠商於投標時，不得附加任何條件。

六、押標金：

1. 押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。
2. 押標金應以現金、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。
3. 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於開標後掛號無息寄回投標廠商。

七、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

1. 投標時間截止後之投標。
2. 開標前業已公告停止本標案交易程序。
3. 投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。
4. 投標單附加任何成交條件者。
5. 投標文件之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。
6. 投標文件有所缺漏者。但押標金不足者，工研院得要求投標廠商補足，若於決標前未能補足者，其投標為無效。

八、決標方法：

1. 開標日為 108年10月2日。
2. 開標時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、廠商基本資料表進行審查及確認。

3. 同一案以投標廠商出價金額最高且高於底價者得標。同一案有二家（含）以上投標金額相同時，由工研院現場抽籤決之。
4. 開標時將請律師到場監標。
5. 開標後將個別通知投標廠商開標結果（不公告得標廠商）。
6. 對於流標、廢標或無效投標之「讓與標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。

九、契約事項：

1. 得標廠商應於接獲得標通知起 30 個工作天內，與工研院簽訂「讓與契約書」。各項契約條件應以工研院與得標廠商正式簽訂之「讓與契約書」為準。工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」之權利。
2. 得標廠商如屆期未與工研院簽訂「讓與契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格（但經工研院同意者，不在此限）；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。
3. 得標廠商與簽訂「讓與契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。
4. 得標廠商就「讓與標的」同意遵守中華民國相關法令之規定（包括但不限於介入權、境外實施等規定）。前述法令變動時，亦同。
5. 得標廠商取得「讓與標的」應支付工研院讓與費用，讓與費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。
6. 得標廠商簽署「讓與契約書」且生效時，本標案簽約保證金移充為「讓與契約書」之讓與費用。
7. 「讓與契約書」經雙方依法簽章報經濟部同意後生效。得標廠商充分了解「讓與標的」之讓與依規定須送經濟部核准，且工研院對於經濟部之意見並無影響能力。
8. 得標廠商同意經濟部及/或工研院就「讓與標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與第三人時，並應使該第三人同意本條約定。再為專屬授權或讓與時亦同。
9. 得標廠商應就「讓與標的」之一部或全部，承受於「讓與契約書」生效前：1.工研院已與第三人簽訂之授權契約；2.工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；及 3.工研院已承諾不會對特定之人及特定產品行使專利權。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與他人時，並應使該專屬被授權人或受讓人同意本條約定。前述受讓人再為專屬授權或讓與時亦同。

10. 得標廠商同意並承認，「讓與契約書」僅為工研院同意讓與「讓與標的」予得標廠商。工研院亦僅依本標案公告日之「讓與標的」現狀辦理本標案並交付得標廠商，工研院不擔保「讓與標的」之尚在申請中之專利可獲證，或可依原始申請範圍獲證，或已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「讓與標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「讓與標的」所製造產品之產品責任。「讓與標的」之未獲證或被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「讓與標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」生效後，「讓與標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責，概與工研院無涉；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「讓與標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「讓與標的」之諮詢講解或訓練之義務。
11. 「讓與標的」之讓與登記手續由得標廠商負責辦理，並由得標廠商負擔讓與手續所須之一切費用。雙方將互相配合以辦理讓與登記手續。得標廠商應自「讓與契約書」生效之日起負擔「讓與標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「讓與標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。
12. 「讓與標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之法令規定，配合工研院為一切必要之申請，並應將其檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提供工研院。得標廠商應配合工研院向主管機關(包含但不限經濟部，以下同)為一切必要之申請(包括但不限於境外實施之申請等)，並應提供一切相關之文件。得標廠商應於取得工研院及/或主管機關之核准及同意後始得為之：
 - (1) 得標廠商在我國管轄區域(係指台、澎、金、馬，下同)外自行使用、實施者；
 - (2) 得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；
 - (3) 得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；
 - (4) 得標廠商讓與「讓與標的」之對象非我國研究機構或企業者。

13. 得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得終止全部或部分「讓與契約書」，並得將「讓與標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「讓與標的」收歸國有：

- (1) 得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「讓與標的」，且他人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。
- (2) 得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「讓與標的」者。
- (3) 為增進國家重大利益者。

有本項情形時，工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

14. 得標廠商如將「讓與標的」之全部或一部授權或讓與第三人（以下稱「後手」）時，應將相關授權或讓與對象事前通知工研院，以便工研院向主管機關陳報運用所生之產業效益。
15. 得標廠商應使所有「後手」遵守本條第 8 項至第 10 項、第 12 項至第 14 項、第 16 項及第 17 項之約定。得標廠商應與「後手」約定，如「後手」違反前述約定者，工研院得直接對「後手」主張權利。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。
16. 基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對第三人就「讓與標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院。得標廠商於「讓與契約書」生效後對第三人就「讓與標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。
17. 得標廠商於「讓與契約書」生效後，因股權變動而產生或增加陸、港、澳投資時，應於事實發生後 30 日內，以書面通知工研院，工研院若認為有違反政府法令規定或損及我國整體產業及技術發展之虞時，得以書面敘明理由通知得標廠商後解除「讓與契約書」。

十、領標方式：

有意投標者，請與工研院「技轉法律中心」聯絡人（請詳十二、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

十一、注意事項：

本標案公告為「讓與契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本公告、「讓與標的」、投標單及相關資訊之內容。



各該內容如有不清楚或抵觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

十二、聯絡方式：

本公告相關問題請洽詢：

工研院「技轉法律中心」方先生

電話：(03) 591-4466，傳真：(03) 582-0466

電子信箱：dennis_fang@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室



附件：讓與標的清單

專利分類	案次	案編號	件次	件編號	專利名稱	國家	申請號/專利號	狀態	專利起期	專利迄期	委辦單位
光電構裝/封裝材料 (11案30件)	1	054910019	1	054910019CN	適用於製備各向導性導電膠組合物的微導電粉體	CN	ZL02140783.5	獲證	20050608	20220723	經濟部技術處
		054910019	2	054910019US	適用於製備異方性導電膠組合物的微導電粉體	US	6,841,094	獲證	20050111	20230804	經濟部技術處
	2	P05910053	3	P05910053CN	半導體裝置封裝方法	CN	ZL03131348.5	獲證	20060607	20230513	經濟部技術處
		P05910053	4	P05910053TW	半導體裝置封裝方法	TW	205929	獲證	20040611	20230313	經濟部技術處
		P05910053	5	P05910053US	半導體裝置封裝方法	US	6,821,818	獲證	20041123	20230803	經濟部技術處
	3	P05940068	6	P05940068CN	非導電黏著材料組成物	CN	ZL200510137453.X	獲證	20081203	20251229	工研院
		P05940068	7	P05940068TW	非導電黏著材料組成物	TW	I322171	獲證	20100321	20251228	工研院
	4	P54000123	8	P54000123CN	有機-無機金屬氧化物混成樹脂、其形成方法、及其形成的透明樹脂組合物	CN	ZL201210268417.7	獲證	20160323	20320729	經濟部技術處
		P54000123	9	P54000123TW	有機-無機金屬氧化物混成樹脂、其形成方法、及其形成的樹脂組成物	TW	I565732	獲證	20170111	20320612	經濟部技術處
		P54000123	10	P54000123US	有機-無機金屬氧化物混成樹脂、其形成方法、及其形成的樹脂組成物	US	8,721,919	獲證	20140513	20321105	經濟部技術處
	5	P54020087	11	P54020087CN	有機無機混成樹脂、包含其的模塑組合物、以及光電裝置	CN	ZL201510015066.2	獲證	20180206	20350112	經濟部技術處
		P54020087	12	P54020087TW	有機無機混成樹脂、包含其之模塑組合物、以及光電裝置	TW	I516544	獲證	20160111	20341224	經濟部技術處
		P54020087	13	P54020087US	有機無機混成樹脂、包含其之模塑組合物、以及光電裝置	US	9,617,411	獲證	20170411	20350414	經濟部技術處
	6	P54040021	14	P54040021CN	矽氧烷組合物、以及包含其的光電裝置	CN	201610027912.7	申請中	申請中	申請中	經濟部技術處
		P54040021	15	P54040021TW	矽氧烷組成物、以及包含其之光電裝置	TW	I557183	獲證	20161111	20351215	經濟部技術處
		P54040021	16	P54040021US	矽氧烷組成物、以及包含其之光電裝置	US	9,540,488	獲證	20170110	20351229	經濟部技術處
	7	P54040025	17	P54040025CN	光學固態預聚物與模塑組合物	CN	201610036868.6	獲證	20190423	20360119	經濟部技術處
		P54040025	18	P54040025TW	光學固態預聚物與模塑組合物	TW	I570187	獲證	20170211	20351216	經濟部技術處
		P54040025	19	P54040025US	光學固態預聚物與模塑組合物	US	9,773,958	獲證	20170926	20360203	經濟部技術處
	8	P54060019	20	P54060019CN	封裝材料與薄膜	CN	201811235415.1	申請中	申請中	申請中	經濟部技術處



專利分類	案次	案編號	件次	件編號	專利名稱	國家	申請號/專利號	狀態	專利起期	專利迄期	委辦單位
有機太陽能電池 (9案 21件)	9	P54060019	21	P54060019TW	封裝材料與薄膜	TW	I648347	獲證	20190121	20371031	經濟部技術處
		P54060019	22	P54060019US	封裝材料與薄膜	US	16/175,283	申請中	申請中	申請中	經濟部技術處
	9	P54950068	23	P54950068CN	封裝材料組合物	CN	ZL200610172320.0	獲證	20101013	20261229	經濟部技術處
		P54950068	24	P54950068TW	封裝材料組成物	TW	I328598	獲證	20100811	20261225	經濟部技術處
	10	P54960038	25	P54960038CN	發光二極管的封裝材料組成物	CN	ZL200710162896.3	獲證	20120620	20271021	經濟部技術處
		P54960038	26	P54960038TW	發光二極體的封裝材料組成物	TW	I367900	獲證	20120711	20271008	經濟部技術處
		P54960038	27	P54960038US	發光二極體的封裝材料組成物	US	8,013,039	獲證	20110906	20290718	經濟部技術處
	11	P54990046	28	P54990046CN	矽氧烷環氧樹脂透明組合物	CN	ZL201010619696.8	獲證	20150311	20301230	經濟部技術處
		P54990046	29	P54990046TW	矽氧烷環氧樹脂透明組成物	TW	I410445	獲證	20131001	20301228	經濟部技術處
		P54990046	30	P54990046US	矽氧烷環氧樹脂透明組成物	US	8,440,774	獲證	20130514	20310331	經濟部技術處
	12	P54000012	31	P54000012TW	富勒烯衍生物與光電元件	TW	I431002	獲證	20140321	20310529	經濟部技術處
		P54000012	32	P54000012US	富勒烯衍生物與光電元件	US	8,741,448	獲證	20140603	20321011	經濟部技術處
	13	P54010020	33	P54010020TW	P型有機半導體材料與光電元件	TW	I485145	獲證	20150521	20321025	經濟部技術處
		P54010020	34	P54010020US	P型有機半導體材料與光電元件	US	8,907,108	獲證	20141209	20330425	經濟部技術處
	14	P54950026	35	P54950026TW	單核多枝狀星型高分子材料與有機薄膜電晶體	TW	I331611	獲證	20101011	20261122	經濟部技術處
		P54950026	36	P54950026US	單核多枝狀星型高分子材料與有機薄膜電晶體	US	7,928,430	獲證	20110419	20280213	經濟部技術處
	15	P54950051	37	P54950051CN	太陽能電池	CN	ZL200710102141.4	獲證	20100106	20270428	經濟部技術處
	16	P54950122	38	P54950122TW	用於太陽能電池之主動層及其製造方法	TW	I339914	獲證	20110401	20261228	經濟部技術處
17	P54960002	39	P54960002CN	有機薄膜晶體管以及控制高分子材料層表面能的方法	CN	ZL200710161979.0	獲證	20100915	20270926	經濟部技術處	
	P54960002	40	P54960002TW	有機薄膜電晶體以及控制高分子材料層表面能的方法	TW	I344216	獲證	20110621	20270813	經濟部技術處	
18	P54960084	41	P54960084CNC1	可溶性聚噻吩衍生物	CN	200910001233.2	申請中	申請中	申請中	經濟部技術處	
	P54960084	42	P54960084DE	可溶性聚噻吩衍生物	DE	EP2075274	獲證	20100602	20281221	經濟部技術處	
	P54960084	43	P54960084ES	可溶性聚噻吩衍生物	ES	EP2075274	獲證	20100602	20281221	經濟部技術處	
	P54960084	44	P54960084GB	可溶性聚噻吩衍生物	GB	EP2075274	獲證	20100602	20281221	經濟部技術處	
	P54960084	45	P54960084JP	可溶性聚噻吩衍生物	JP	5253146	獲證	20130426	20281225	經濟部技術處	



專利分類	案次	案編號	件次	件編號	專利名稱	國家	申請號/專利號	狀態	專利起期	專利迄期	委辦單位
		P54960084	46	P54960084JPC1	可溶性聚噻吩衍生物	JP	5179415	獲證	20130118	20290311	經濟部技術處
		P54960084	47	P54960084TWC1	可溶性聚噻吩衍生物	TW	I375691	獲證	20121101	20281221	經濟部技術處
		P54960084	48	P54960084US	可溶性聚噻吩衍生物	US	7,754,847	獲證	20100713	20280729	經濟部技術處
		P54960084	49	P54960084USC1	可溶性聚噻吩衍生物	US	8,058,387	獲證	20111115	20280625	經濟部技術處
	19	P54970072	50	P54970072TW	應用於高分子太陽能電池之染料分子及包括此染料分子之高分子太陽能電池	TW	I385167	獲證	20130211	20281110	經濟部技術處
	20	P54970097	51	P54970097TW	串/並疊型有機太陽能電池	TW	I369011	獲證	20120721	20281230	經濟部技術處
其他 (2案 2件)	21	P02940021	52	P02940021TW	高膨潤性及高反應官能基含量之球形基材及其製造方法	TW	I302925	獲證	20081111	20251005	經濟部技術處
	22	P02940067	53	P02940067TW	水溶性磁性奈米微粒之製造方法	TW	I309663	獲證	20090511	20251229	經濟部技術處